

### Neuinvestition in eine UltraSpeed mono von Posalux für die Bearbeitung von Metallkern-Leiterplatten

Bislang erfolgte die mechanische Bearbeitung von Metallkern-Leiterplatten meist in zwei getrennten Arbeitsschritten. Die addierenden Toleranzen der einzelnen Aufspan- und Arbeitsschritte führten zu einem Verlust der Positionsgenauigkeit. Nicht so beim neuen Bohr- und Fräsaufautomaten Posalux Mono – der neuen, flexiblen Lösung für das Bohren und Fräsen von [Metallkern-Leiterplatten](#).

Mit dieser ersten Anlage Europas, die in enger Abstimmung mit Varioprint nach unserem Pflichtenheft entwickelt wurde, können wir unseren Kunden bei neuen Produktdesigns und Konstruktionen wertvolle Unterstützung bieten.

Die präzise Bearbeitung von Metallkernleiterplatten, ob aus Kupfer, Messing oder Aluminium, eröffnen Ihnen neue verbesserte Möglichkeiten im Bereich des Wärmemanagements.



**Getreu dem Motto  
Vertrauen – Verantwortung – Verlässlichkeit**

bleiben wir auch in Zukunft am Ball, um anspruchsvolle und innovative Leiterplattenlösungen bieten zu können! Unsere Spezialisten freuen sich auf Ihre Anfrage. Kontaktieren Sie uns.



**"Unsere neue Posalux Mono ermöglicht präzises und prozessoptimiertes Arbeiten in der für Varioprint gewohnten hohen Qualität!"**

Bruno Dobler - Prozessleiter Mechanik

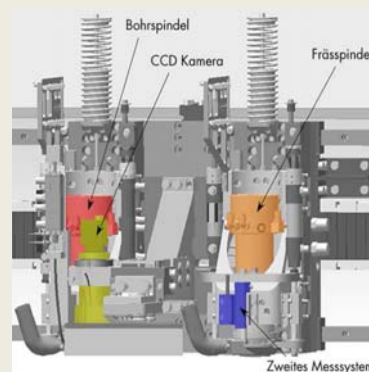
### September 2014

#### Kombikonzert mit zwei Spindeln

Eine kugelgelagerte Spindel 5k – 70k U/Min mit Sprühnebelkühlung für die Metallbearbeitung sowie effizientes Schruppen mit grossem Materialabtrag kombiniert mit einer luftgelagerten Spindel 20k – 125k U/Min zum Schlichten und für konventionelle Leiterplattenbearbeitung.

#### Linearantriebe für X, Y und Z Achsen Positionierung

Positioniergenauigkeit bis  $\pm 15 \mu\text{m}$  in X- und Y-Achse sowie  $\pm 10 \mu\text{m}$  in der Z-Achse bei Kontaktbohren bzw.  $\pm 15 \mu\text{m}$  beim Kontakttiefenfräsen.



#### CCD Sensor zu optischen Registration

ermöglichen die präzise Messung von Targets und Fiducials, sowie die Berechnung von Korrekturfaktoren und Oberflächendetektion für perfekte Resultate beim Tiefenfräsen von Cavities oder Kanälen.

Gerne begrüssen wir Sie an der

#### Electronica in München

11. bis 14. November 2014



**Halle A2  
Stand 628**